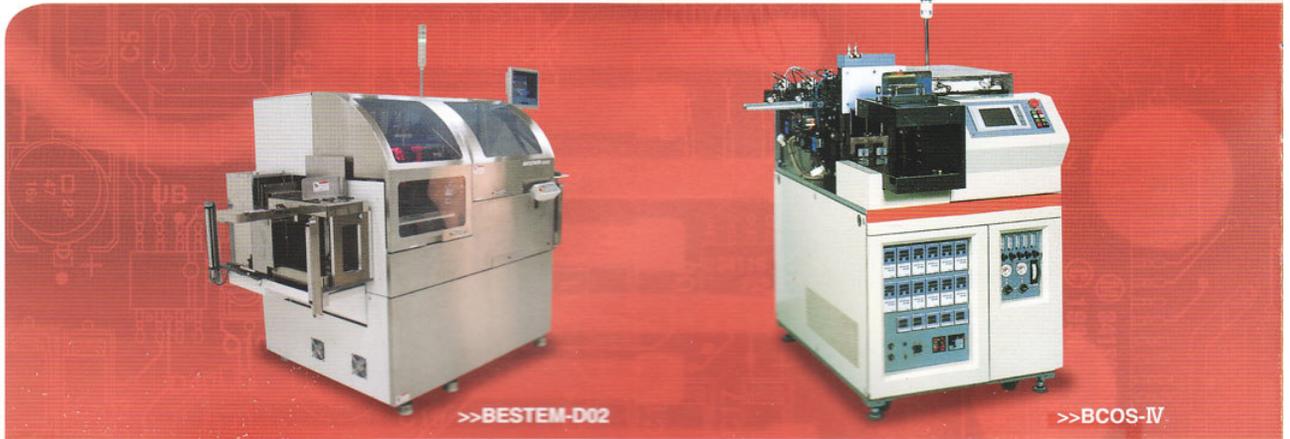


LSI/MEMORY

All lineup of our products, The world knows that.



>>BESTEM-D02

>>BCOS-IV

Front End ▶▶▶

	ダイボンディング Die Bonding	キュア Curing
QFP		
COMMON	<p>BESTEM-D02 φ300ダイボンダー φ300 Die Bonder</p> <ul style="list-style-type: none"> φ12インチ対応 UPH10000を実現 For φ12 inch, achieved UPH10000 <p>ダイボンダー Die Bonder</p> <p>ニードルレスピックアップ技術 Needleless pick up technology</p>	<p>BCOS-IV インラインキュア炉 In-Line Curing Oven</p> <ul style="list-style-type: none"> 均一加熱、クリーンキュア (品種切替マニュアル) Even heating, clean cure(Manual conversion) <p>キュア Curing</p>
BGA CSP		



>>FLAG-300



>>CAP-300II

Back End ▶▶▶

捺印
Marking

切断
Cutting

測定
Testing

洗浄
Rinsing

検査
Inspecting

FLAG-300 フレキシブルレーザーグラフ
Flexible Lazer Graph

- ・CSP, BGAフレームにも対応
- ・Prepared for CSP and BGA frame

捺印
Marking

SDM Series シングレーションマシン
Singulation Machine

- ・ウエハー、基板の切断・洗浄・検査・挿入
- ・Cutting, rinsing, inspecting, and inserting wafer and board

切断
Cutting

洗浄
Rinsing

検査
Inspecting

